



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Numéro de publication : **0 521 778 A1**

(12)

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **92401868.2**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup> : **G06K 19/06**

(22) Date de dépôt : **30.06.92**

(30) Priorité : **02.07.91 FR 9108248**

(43) Date de publication de la demande :  
**07.01.93 Bulletin 93/01**

(84) Etats contractants désignés :  
**DE ES FR GB IT NL**

(71) Demandeur : **GEMPLUS CARD  
INTERNATIONAL  
avenue du Pic de Bretagne, Parc d'activités  
de la Plaine de Jouques  
F-13420 Gemenos (FR)**

(72) Inventeur : **Coiton, Gérard  
Cabinet Ballot-Schmit, 7, rue le Sueur  
F-75116 Paris (FR)  
Inventeur : Farrugia, Augustin  
Cabinet Ballot-Schmit, 7, rue le Sueur  
F-75116 Paris (FR)**

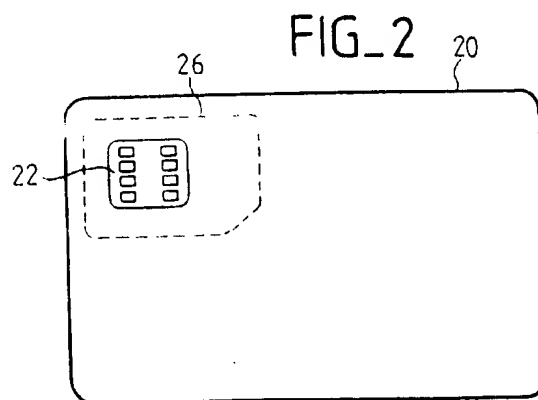
(74) Mandataire : **Schmit, Christian Norbert Marie  
et al  
Cabinet Ballot-Schmit 7, rue Le Sueur  
F-75116 Paris (FR)**

(54) **Fabrication de cartes à puce à module autodétachable.**

(57) L'invention concerne la fabrication de cartes à puces.

Pour réduire le coût de fabrication dans le cas de cartes à puces de format plus petit que le format habituel, on propose d'effectuer toutes les étapes de fabrication, y compris le test et la personnalisation imprimée des surfaces visibles de la carte, sur une carte (20) de format standard, puis de découper en fin de processus une carte de format réduit dans la carte standard.

Une prédécoupe partielle est effectuée le long d'une ligne (26), soit par amincissement de la carte sur tout le pourtour de la carte de format réduit, soit par une fente suivant ce pourtour, cette fente étant interrompue localement pour laisser subsister des ponts de maintien provisoire entre la carte de format réduit et le reste de la carte standard.



L'invention concerne les cartes à microcircuit électronique, plus généralement connues sous le nom de cartes à puces.

Un des problèmes qu'on rencontre fréquemment pour les produits de très grande diffusion est celui de la normalisation pour que des produits émanant de plusieurs constructeurs différents puissent être utilisés dans les mêmes appareils.

C'est le cas en particulier des cartes à puces : elles sont utilisées par exemple dans les appareils téléphoniques publics, dans des lecteurs de cartes associés à des ordinateurs personnels, dans des applications bancaires, etc. Il a donc fallu adopter des normes précises de construction que tous les constructeurs doivent respecter. Le grand public connaît maintenant très bien le format qui a été adopté, au moins en ce qui concerne les dimensions extérieures de la carte : c'est le format des cartes de crédit classiques à pistes magnétiques; la carte à puce est un rectangle d'environ 8,5 cm de long sur 5,4 cm de large et un peu moins d'un millimètre d'épaisseur (normes internationales IS 7816-1 et 7816-2 aujourd'hui).

Il en résulte bien entendu que les machines de fabrication de cartes à puces sont construites en fonction de ces normes, pour pouvoir produire des cartes qui respectent les normes.

Mais dans certaines applications, on s'aperçoit que ce format n'est pas idéal. C'est le cas en particulier pour des applications miniaturisées. Par exemple, lorsqu'une carte à puce doit être utilisée dans un boîtier portatif de très petites dimensions, il n'est pas certain que le format actuel, malgré sa petite taille, reste acceptable. A titre d'exemple, on peut citer le radiotéléphone numérique futur, dont le boîtier portatif devrait utiliser des cartes à puces de format beaucoup plus petit que le format actuel.

L'invention vise à proposer une solution technique économique pour réaliser des cartes à puces de format plus petit que le format généralement utilisé.

Selon l'invention on propose de réaliser les cartes à puces au format standard le plus courant, et de les découper ensuite.

De manière particulièrement avantageuse, on propose que les cartes au format standard soient pourvues d'une prédécoupe locale partielle aux dimensions désirées autour du microcircuit contenu dans la carte.

Cette prédécoupe partielle permet notamment de détacher de la carte de dimensions standard une carte de dimensions réduites prédéterminées.

Le détachement est fait seulement après la fin de toutes les opérations de fabrication, de test, et de personnalisation imprimée, de sorte que l'on peut utiliser tous les appareils standard de fabrication et de test sans aucune contrainte due aux dimensions réduites désirées pour la carte finale.

Par conséquent, le coût de fabrication est réduit puisqu'il n'est pas nécessaire d'investir dans des

équipements de fabrication supplémentaires coûteux, uniquement à cause de ces problèmes de dimensions.

Un autre avantage important de la prédécoupe faite autour du micromodule existe également dans le cas où la partie prédécoupée n'est pas détachée : la carte reste au format standard. Dans ce cas, la partie intérieure à la prédécoupe, celle qui contient le micromodule électronique, est mécaniquement découplée de la carte, c'est-à-dire qu'elle subit beaucoup moins les contraintes de flexion et de torsion dues à la manipulation de la carte.

La prédécoupe peut être un amincissement de l'épaisseur de la carte sur tout le pourtour de la carte au format réduit. Ce peut être aussi une découpe sur toute l'épaisseur en laissant de place en place de petites régions non découpées qui forment des ponts entre la carte de format réduit et le reste de la carte au format standard. Ces ponts assurent le maintien de la carte au format réduit dans la carte au format normal jusqu'au détachement final.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit et qui est faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente une carte à puce au format standard actuel pour la majorité des applications;
- la figure 2 représente le principe de l'invention pour la réalisation d'une carte de format réduit;
- la figure 3 représente la carte terminée;
- la figure 4 représente, en vue agrandie, un exemple de prédécoupe par fente interrompue laissant subsister des ponts de matière.

A la figure 1, on voit une carte à puce 10 très classique, ayant un format standard rectangulaire plat : longueur 8,5 cm; largeur 5,4 cm, épaisseur inférieure à 1 millimètre. Le micromodule électronique 12 qui forme le coeur de la carte est placé dans le coin en haut à gauche. Les contacts d'accès 14 à ce micromodule affleurent à la surface de la carte. En dehors de la zone d'affleurement, le reste de la carte peut servir à des inscriptions personnalisées pour le fournisseur de service ou pour l'utilisateur, de même d'ailleurs que la face arrière de la carte.

La figure 2 représente la mise en oeuvre de l'invention : à partir d'une carte au format standard 20 identique à celle de la figure 1, on effectue tout le processus de fabrication, y compris le test du micromodule 22 (une fois que celui-ci a été mis en place dans la carte avec des contacts affleurants), et la personnalisation des surfaces de la carte par impression de textes et de graphiques.

Mais la carte finale sera beaucoup plus petite et son contour est représenté à la figure 2 par une ligne pointillée 26 entourant le micromodule 22. La carte sera découpée le long de la ligne 26.

Plusieurs procédés peuvent être utilisés et la dé-

coupe peut se faire à divers moments de la fabrication. Elle pourrait par exemple se faire directement en une fois à la fin de la fabrication.

On préfère selon l'invention effectuer à un stade intermédiaire une prédécoupe partielle et non une découpe totale. C'est seulement au stade de l'envoi chez l'utilisateur, ou même chez l'utilisateur au moment de l'insertion dans un lecteur au standard de format réduit, que la carte au format réduit sera détachée de la carte au format standard par simple pression.

La figure 3 représente la carte de format réduit 30 finalement obtenue.

La prédécoupe partielle peut être effectuée de plusieurs manières différentes. Elle consiste à fragiliser le pourtour de la ligne 26 de manière qu'une simple pression des doigts entre la zone de carte 30 et la zone de carte 20 restante permette de détacher la carte 30.

A la figure 4 on a représenté une prédécoupe consistant en une fente 32 sur toute l'épaisseur de la carte; cette fente s'étend sur le pourtour de la ligne 26 qui définit le pourtour de la carte 30, sauf à certains endroits de la ligne 26 où la fente est interrompue et laisse des ponts 34 reliant la carte 30 au reste de la carte 20. Ces ponts 34 sont eux-mêmes d'épaisseur plus faible que la carte de format réduit pour permettre la séparation de celle-ci et du corps de carte de format standard.

On comprendra qu'avec une réalisation telle que celle de la figure 4 tout particulièrement, si le nombre de ponts 34 est faible (par exemple 4 comme cela est représenté), on aboutit à un bon découplage mécanique entre la carte 20 et la carte 30; il est tout-à-fait intéressant de profiter de ce découplage même dans le cas où les cartes restent au format standard, pour obtenir une carte à puce moins sensible aux flexions et aux torsions dues à des conditions d'utilisation et de stockage sévères chez l'utilisateur final.

3. Procédé de réalisation de cartes à puces selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'une carte de format réduit plus petite que le format standard est obtenue en fin de fabrication par séparation de la carte de format réduit le long d'une ligne de prédécoupe (26).

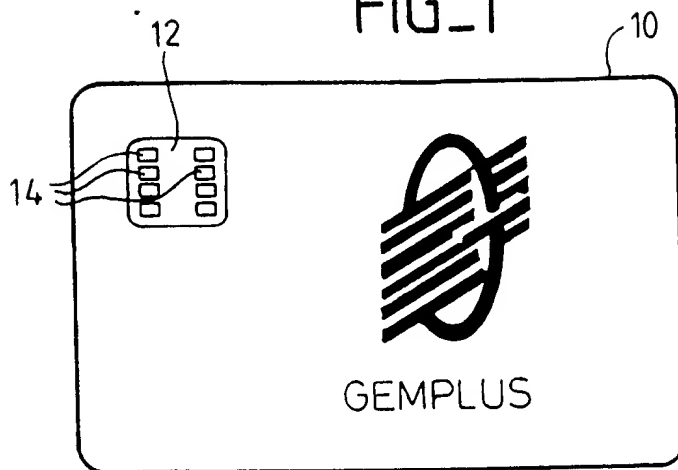
4. Procédé selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que la prédécoupe est constituée par une fente (32) le long du pourtour de la carte de format réduit, cette fente étant interrompue localement pour laisser de place en place des ponts (34) entre la carte de format réduit et le reste de la carte au format standard, ces ponts étant affaiblis en épaisseur au niveau de la carte de format réduit pour permettre la séparation de celle-ci et du corps de carte de format standard.

## Revendications

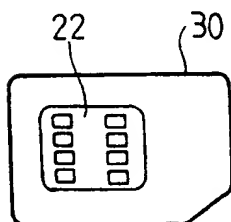
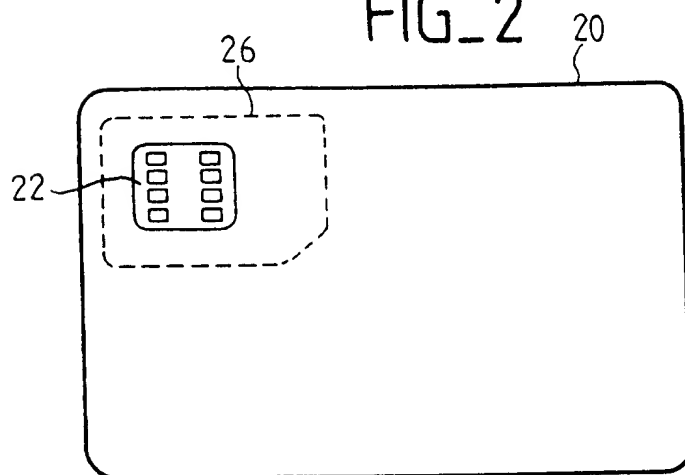
1. Procédé de réalisation de cartes à puces, caractérisé en ce qu'il consiste à effectuer la totalité du procédé de fabrication sur une carte à puce de format standard (20) et à découper ensuite dans cette carte une carte à puce (30) de format plus petit que la carte de format standard.

2. Procédé de réalisation de cartes à puces, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de formation d'une prédécoupe partielle (26) autour d'un micromodule (22) de la carte pour permettre un découplage partiel entre une zone de format réduit contenant le micromodule et le reste d'une carte de format standard.

FIG\_1

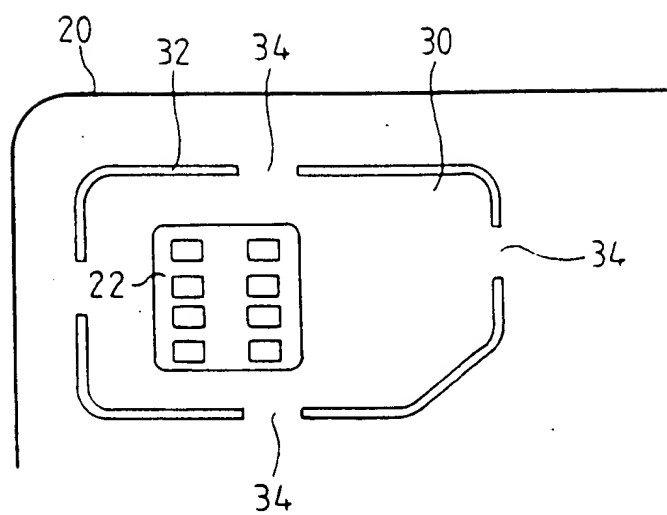


FIG\_2



FIG\_3

FIG\_4





Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 92 40 1868

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 163 880 (GAO) * page 9, ligne 18 - page 11, ligne 1; figures 5-7 *	2	G06K19/06
A	---	1,3,4	
A	FR-A-2 595 848 (MITSUBISHI) * page 4, ligne 34 - page 6, ligne 2; figures 2-4 *	1-3	
A	---		
A	FR-A-2 622 323 (NIPPON EUROTEC) * le document en entier *	1,3	
A	FR-A-2 538 930 (SEIICHIRO) -----		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			G06K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 08 OCTOBRE 1992	Examinateur FORLEN G.A.
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  A : arrière-plan technologique  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date  D : cité dans la demande  L : cité pour d'autres raisons  A : membre de la même famille, document correspondant</p>			